

# 深圳市桑达实业股份有限公司

## 董事和高级管理人员关于重大资产重组摊薄即期回报 及填补措施的承诺函

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份购买中国电子系统技术有限公司 96.7186%股权（以下简称“本次交易”），根据国务院办公厅于 2013 年 12 月发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、国务院于 2014 年 5 月发布的《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2015 年 12 月 30 日发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律、法规及规范性文件（以下简称“法律法规”）的规定，作为上市公司的董事/高级管理人员，本人特出具以下保证与承诺：

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、本人承诺，如后续公司推出股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、本承诺出具日后至公司本次重大资产重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国

证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺本人将根据法律法规承担相应责任。

(以下无正文)

（此页无正文，为《关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的承诺函》之签署页）

全体董事：

---

刘桂林

---

曲惠民

---

韦海东

---

汪军民

---

江小军

---

宋晓风

---

谢庆华

---

吴海

---

徐效臣

深圳市桑达实业股份有限公司

2020年7月31日

（此页无正文，为《关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的承诺函》之签署页）

全体高级管理人员（非兼任董事）：

---

李卫生

---

何 兵

---

吴建华

---

钟 彦

深圳市桑达实业股份有限公司

2020年7月31日